

股票代號：6831

邁科科技股份有限公司

2025年業績發表會

免責宣言

報告內容係依現有資訊而做成，其中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

CONTENTS



- 01 | 公司概況
- 02 | 產品及研發
- 03 | 經營實績
- 04 | 永續發展

01 | 公司概況

關於邁邁

成立日期/公發日期/興櫃日期

2002年11月8日/2021年3月11日/2021年8月11日

實收資本額

新臺幣 600,000,000 元

董事長/總經理/發言人/代理發言人

趙元山先生/林俊宏先生/林仕文先生(協理)/陳建亨先生(副總經理)

主要經營業務

散熱模組研發製造及銷售

公司地址

邁邁科技股份有限公司

新北市中和區中正路788號11樓

惠州惠立勤電子科技有限公司

中國廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)第1-5層

公司網頁

www.microloops.com

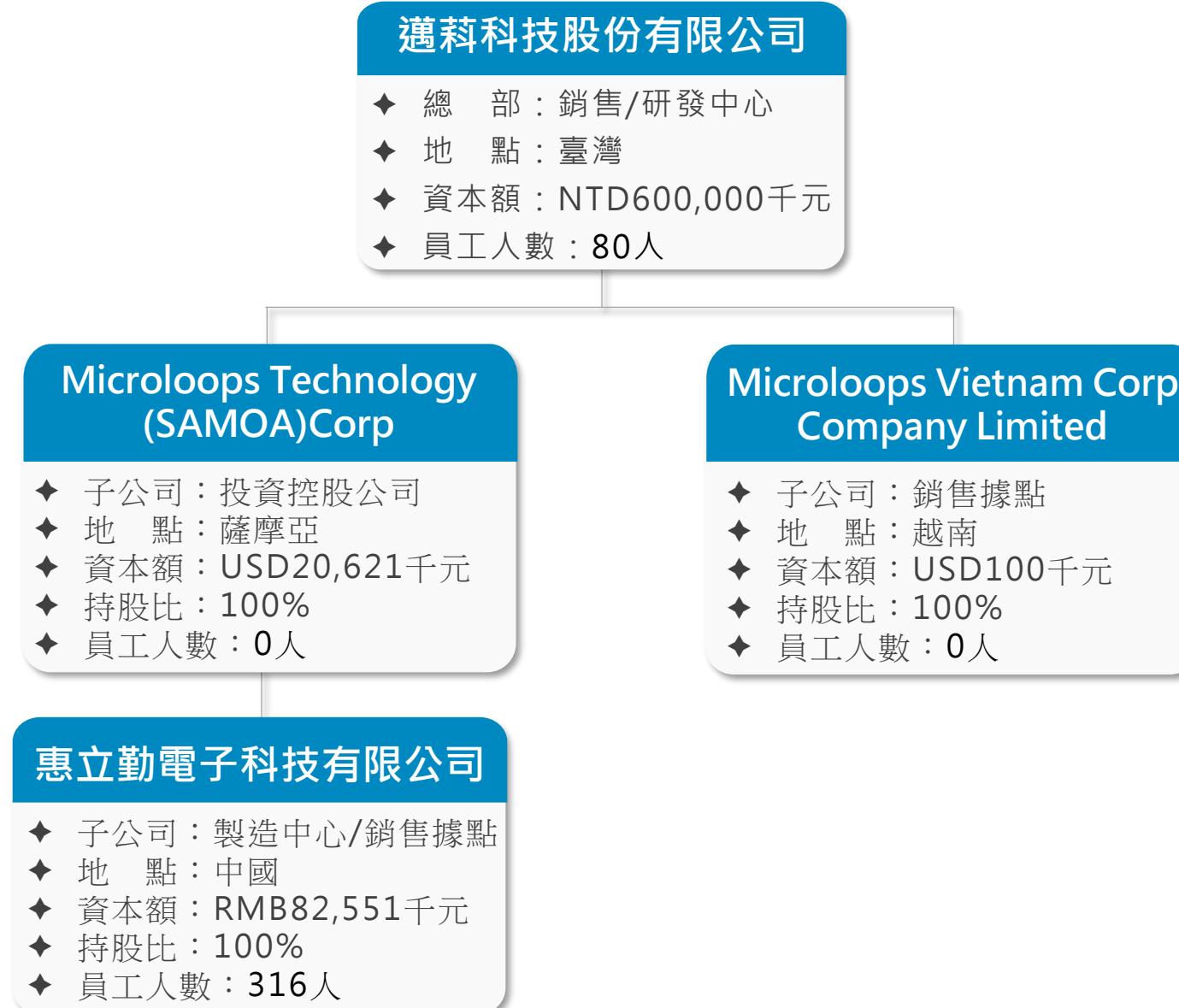
主辦券商&股務代理

宏遠證券股份有限公司

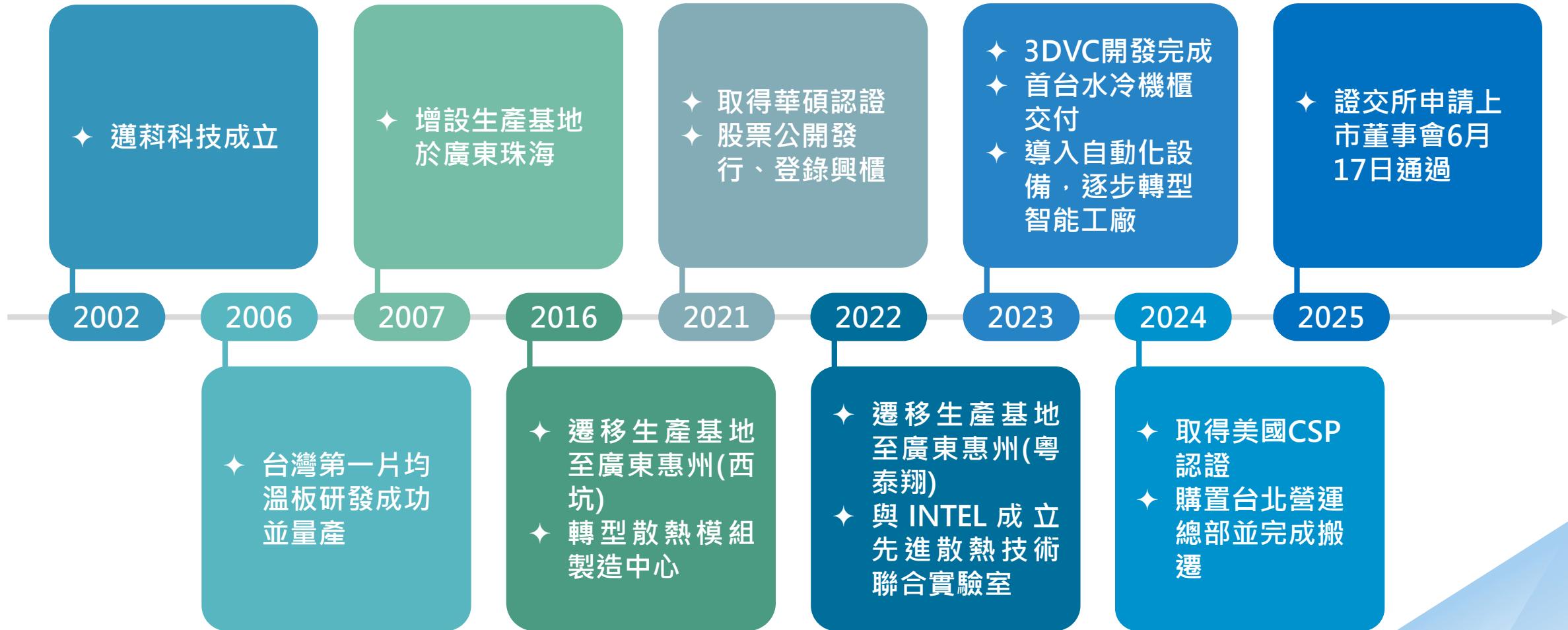
簽證會計師

安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華會計師/余聖河會計師

集團組織架構



重要里程



02 | 產品及研發

主要產品與應用

伺服器與資料中心

- ◆ GPU散熱系統
- ◆ IoT物聯網即時數據處理系統
- ◆ AI加速卡

消費性電子產品

- ◆ 筆記型電腦
- ◆ 高階顯示卡



其他 (含水冷伺服器與車用水冷系統)

- ◆ CDU單/雙向浸沒式水冷
- ◆ 車用電控模組

原材料及主要來源

供應商

● 銅鋁製品

● 銅製品



● 鋁製品



● 風扇

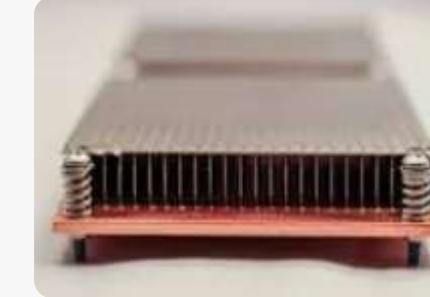
● 風扇



邁荔科技

● 散熱模組

● 散熱模組



產業概況及趨勢(產業分析)

散熱模組產業概況及趨勢

根據Maximize Market Research報告指出，全球熱管理散熱器市場規模受新興應用誕生及電子技術的進步的影響，企業積極開發散熱解決方案以期實現更優異的散熱效果，該報告預估2024~2030年全球散熱器市場將以年複合成長率7.5%成長至117.8億美元，顯示了散熱需求與科技的進步呈現高度正相關且將持續逐年成長。



資料來源：工研院產科國際所，2024/11。



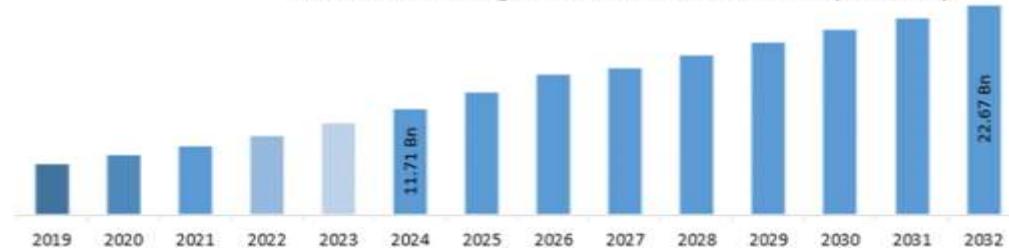
Asia Pacific market accounted largest share in the Global Thermal Management Market in 2024.



8.6% CAGR
Global Thermal Management Market to grow at a CAGR of 8.6% during 2025-2032

Global Thermal Management Market

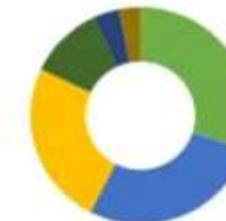
Global Thermal Management Market size in USD Billion (2019-2032)



資料來源：Maximize Market Research，2024/7。

Global Heat Sink Market

Global Heat Sink Market Share (%), By Application - 2023



Market Size in 2023: USD 7.10 Billion

Market Size in 2030: USD 11.78 Billion

CAGR % (2024-2030): 7.5%

Dominated Segment by Type: Active Heat Sinks

Emerging Segment by Material: Copper Heat Sink

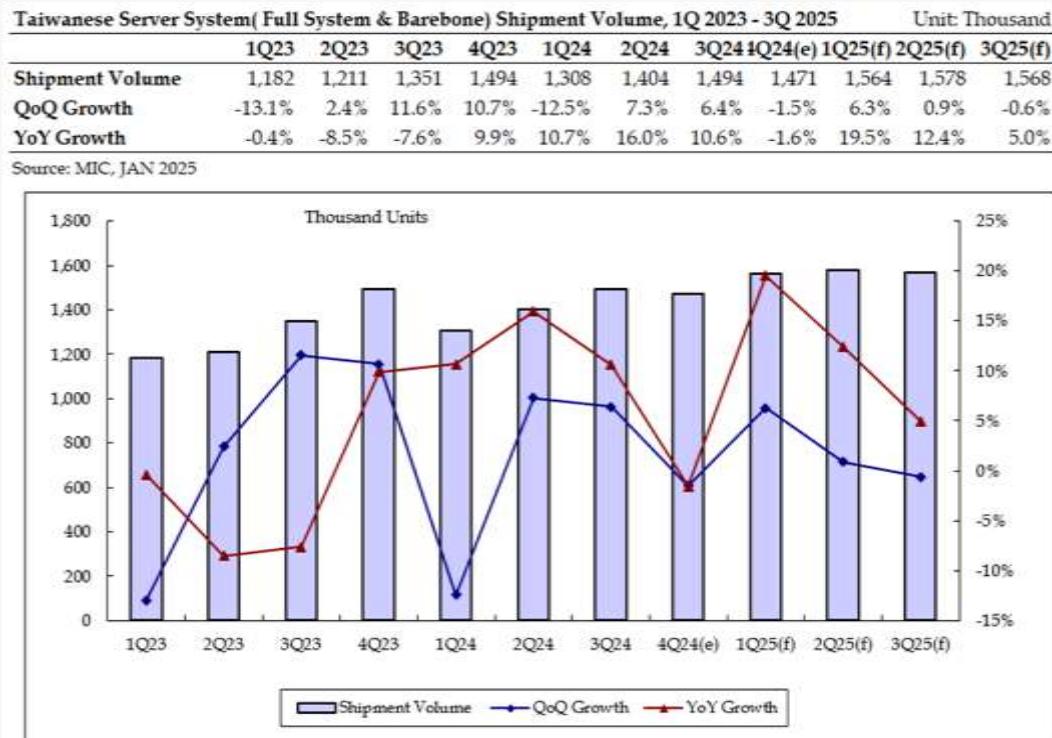
Dominated Region: North America

資料來源：Maximize Market Research，2024/7。

應用產品發展趨勢 (1/3)

1.伺服装及資料中心

我國伺服器出貨量



資料來源：MIC，2025/1。

全球AI伺服器出貨量



資料來源：MIC、TrendForce及TEJ整理。

應用產品發展趨勢 (2/3)

2. 筆記型電腦

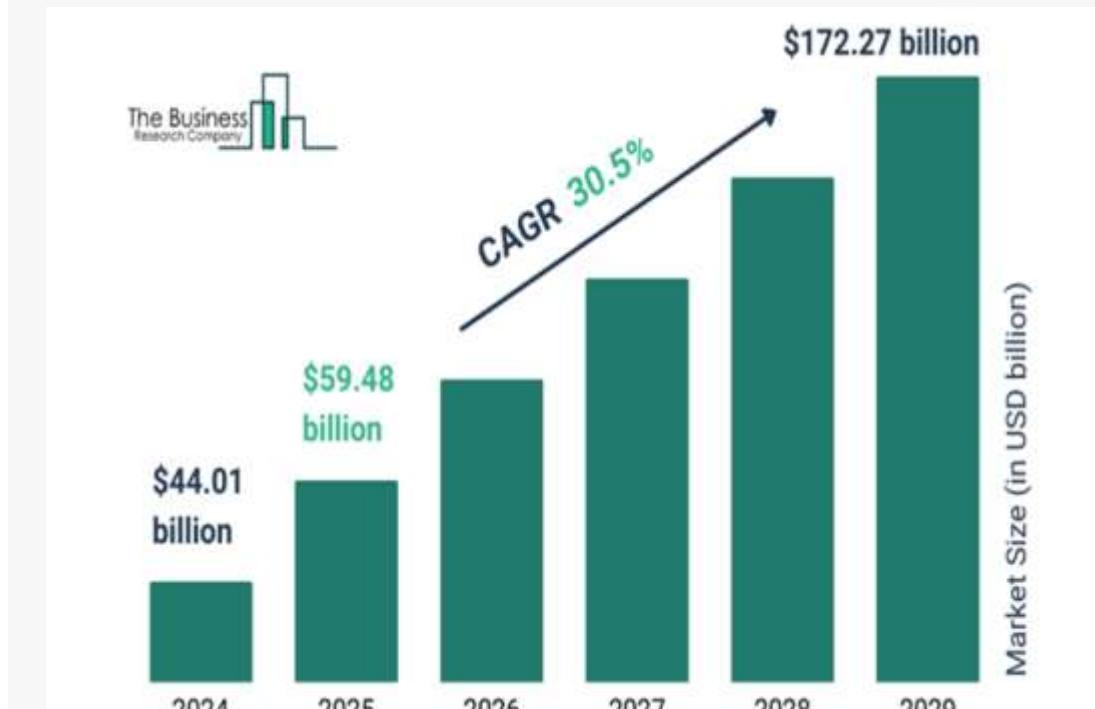
全球筆電出貨量



資料來源：TrendForce · 2024/11。

3. 顯示卡

2025年顯示卡市場規模及成長率



資料來源：The Business Research Company · 2025/1。

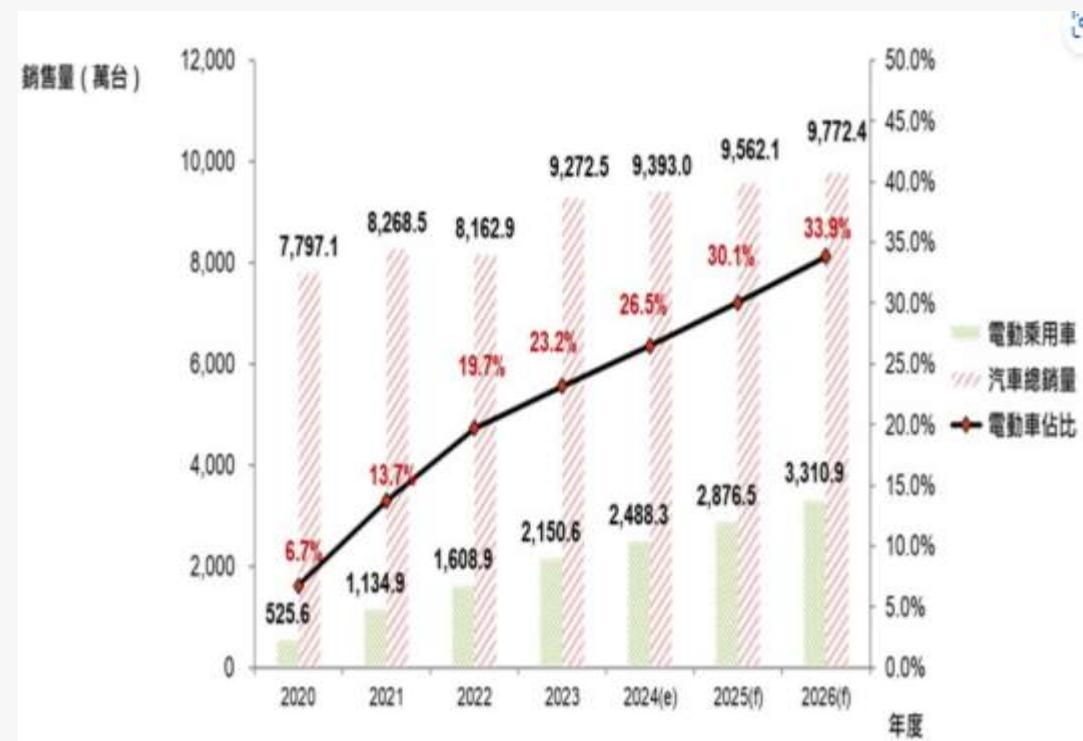
應用產品發展趨勢(3/3)

4. 5G設備

隨著5G及無線輸電技術的持續成熟，5G無線輸電技術的需求可望成為下一個龐大市場，不論是物聯網、電動車市場或智慧家居和智慧城市的应用，有線供電的不便利性勢必將成為無線供電發展的重要推手。根據 Knowledge Sourcing Intelligence的報告顯示，全球無線輸電市場的規模將於2029年達到近400億美元，年複合成長率將達20%。

5. 車用

全球汽車整車銷售概況及預估



資料來源：工研院產科國際所，2025/1。

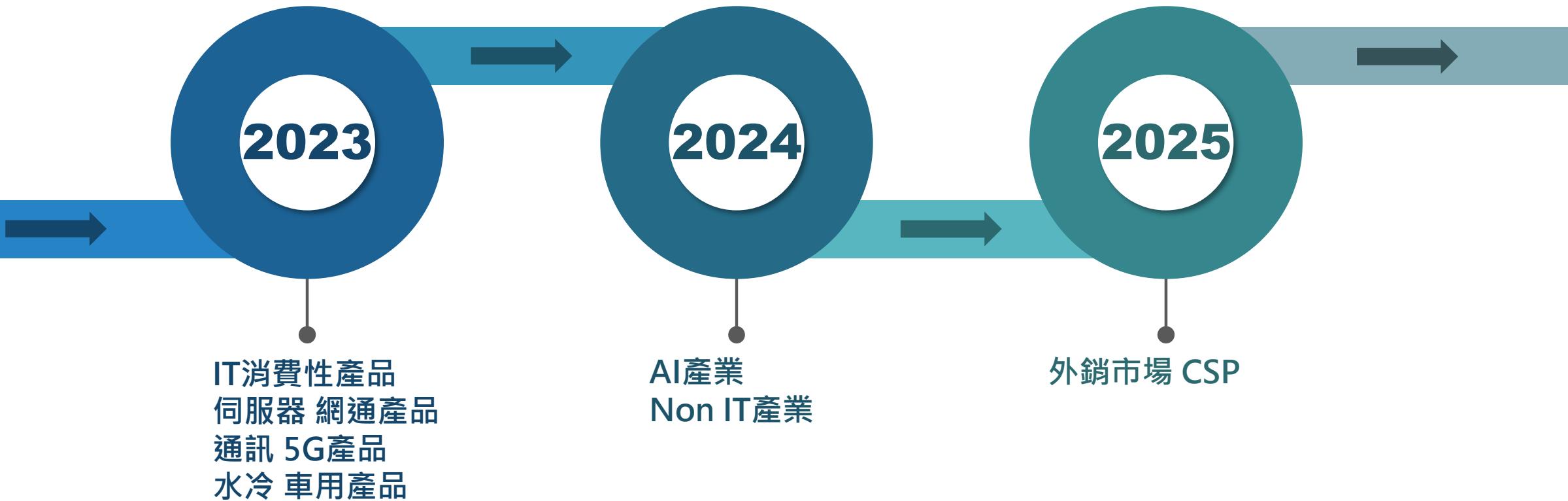
產品應用發展

◆ 短期目標

依產品加深加廣，以現有產品線為主力，維持現有產線產能稼動率暨精實工廠營運。

◆ 中長期目標

新產業與新客戶開發、CSP以及多元發展性、開發利基市場以及利基產品。



產品優勢及核心技術

多領域應用

- ✓ 伺服器
- ✓ 顯示卡
- ✓ 筆記型電腦
- ✓ 網路通訊設備
- ✓ 車用散熱系統

導熱元件核心技術

- ✓ 均溫板
- ✓ 热導管
- ✓ 3DVC

新技術研發

- ✓ 水冷開發
- ✓ 浸沒式水冷

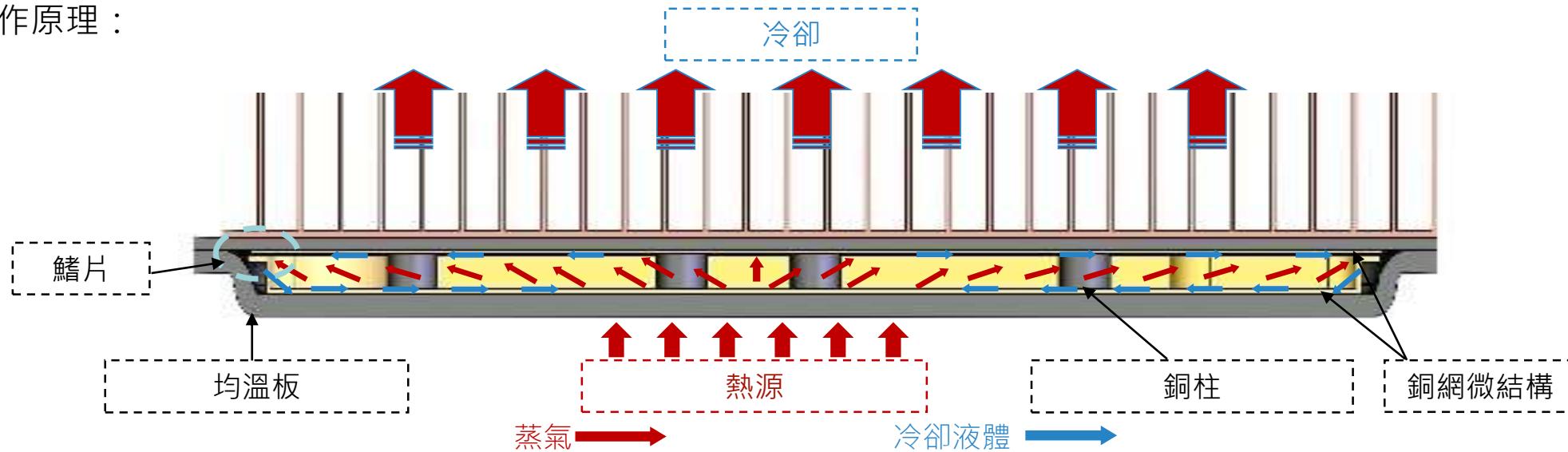
專業客製化能力

- ✓ 產品設計建議
- ✓ 樣品製作
- ✓ 產品後續優化
- ✓ 客製化生產

競爭利基-核心技術

產品優勢

- ◆ 均溫板為高效的導熱結構，能夠集中熱源的熱量擴散至更大區域進行散熱，其效率遠優於銅。
- ◆ 結構為密封容器，內部具有毛細結構，真空處理後，注入工作流體，進行密封。
- ◆ 透過冷卻液體在氣相及液相的變化，進行高效熱傳遞。
- ◆ 工作原理：



競爭利基-核心技術能力

測試與驗證能力

嚴格熱性能測試與可靠性測試，標準化與定制化測試體系滿足客戶需求。

新技術研發與專利布局

自有之關鍵技術與專利，持續投入新世代產品之研發，以追求技術領先。

自動化生產與質量控制

高精度自動化產線，確保產品一致性，以AI質檢監控全流程數據記錄，達可追溯性管理。

01

02

03

04

05

06

07

散熱設計與仿真能力

利用軟件模擬，優化散熱結構並縮短開發周期，降低試錯成本。

精密製造與工藝技術能力

自行研發及製造關鍵元件，擁有各項製造工藝，保障組件氣密性與結構強度。

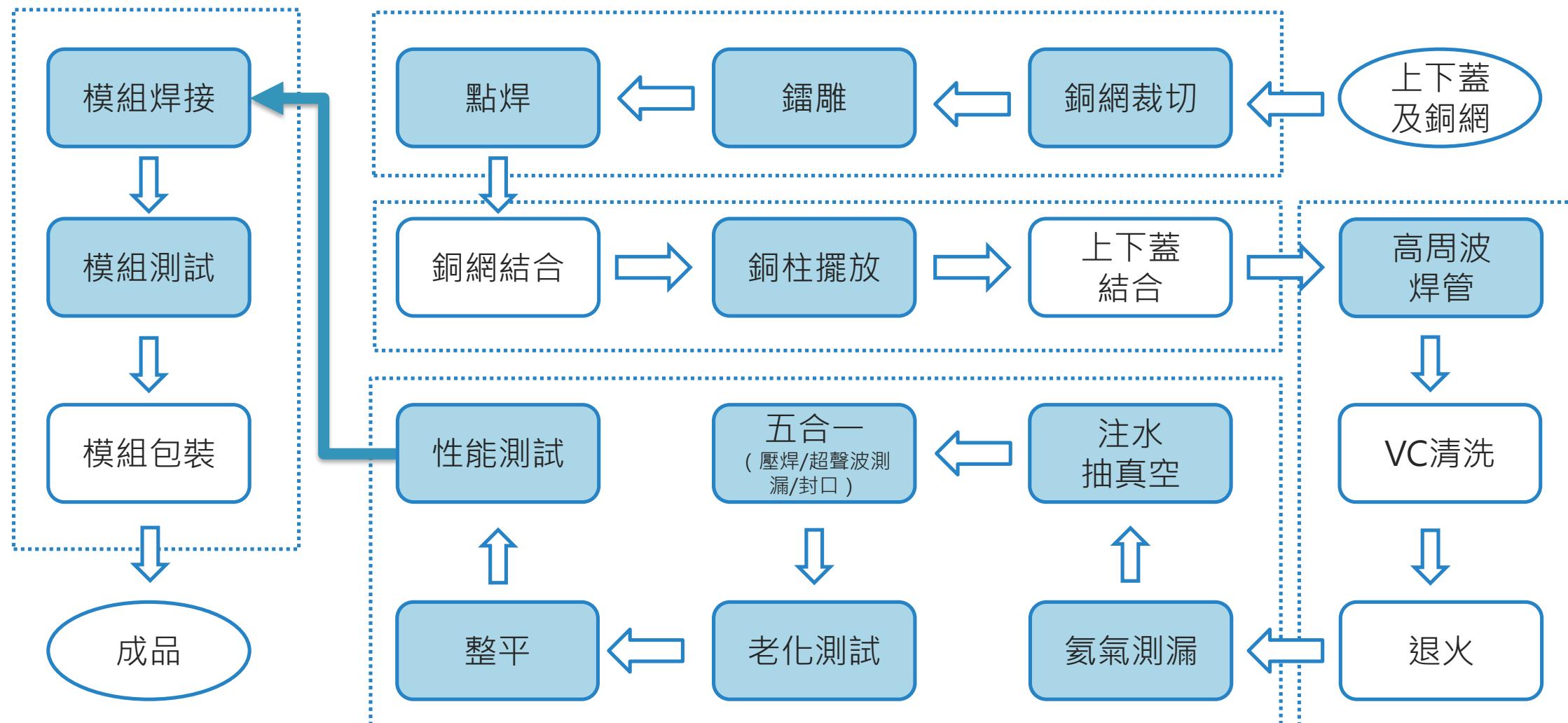
主動散熱與被動散熱整合

依客戶需求，創新及規劃混合散熱方案，實現高效熱傳遞。

跨領域系統集成能力

設計考慮智能化散熱管理，達到集成溫度傳感器，與設備控制系統聯動。

生產流程概略與自動化優勢



新產品 - 3DVC 應用



NVIDIA H100



AWS MX1



Intel Gaudi 3

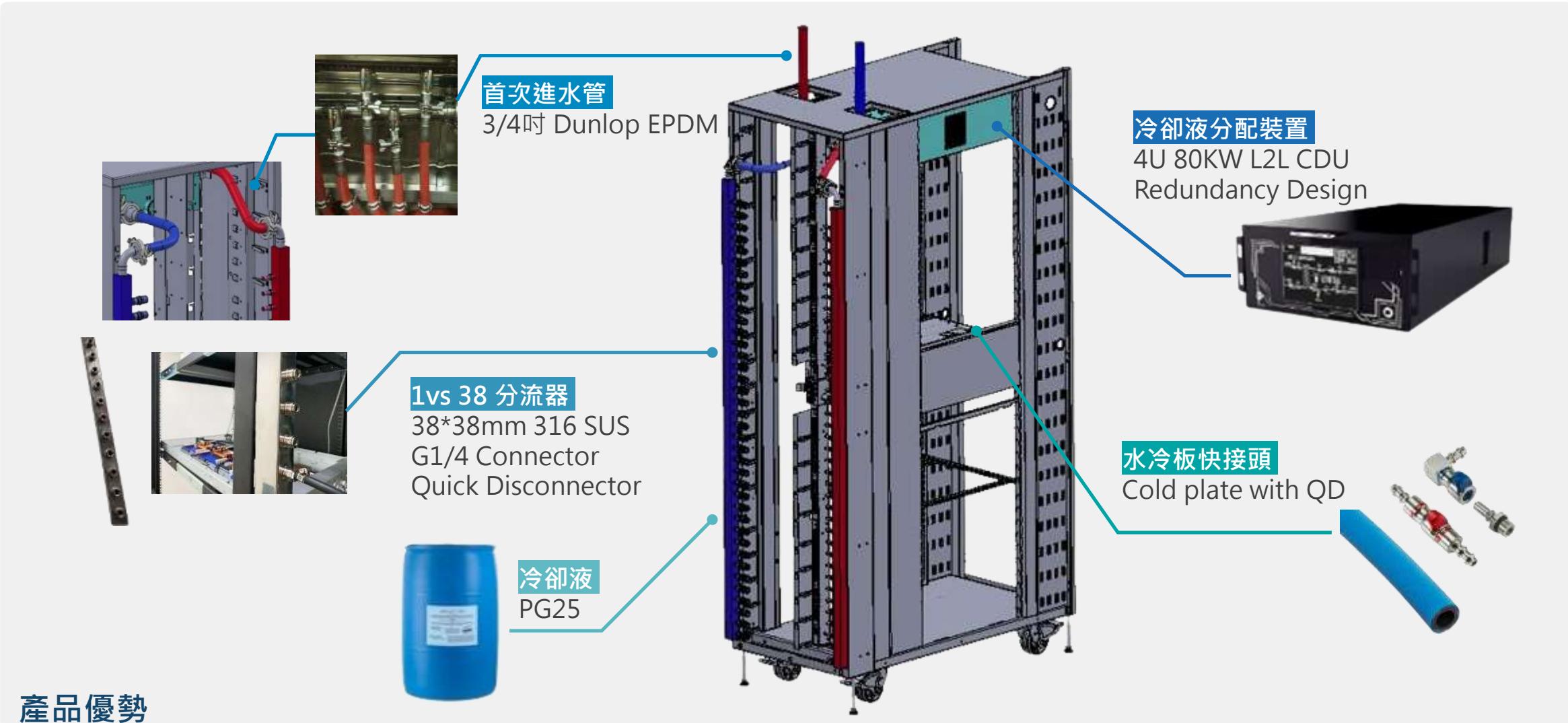


AMD MI 300

產品優勢

- ◆ 業界資歷最久(2006年台灣第一片均溫板研發成功與量產)
- ◆ 效能最高(最高可散熱1500W)
- ◆ 耐用度最久(真空高壓焊10年不洩漏)

新產品 - 水冷應用



產品優勢

- ◆ 業界首創水冷板使用真空高壓焊，確保產品不洩漏。

新產品 - 浸沒式應用 (與Intel共同開發)



邁莉&英特爾先進散熱技術聯合實驗室



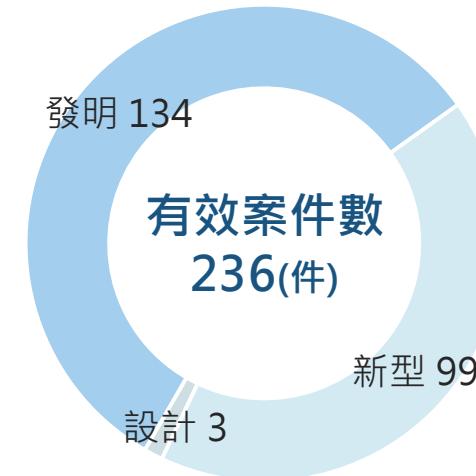
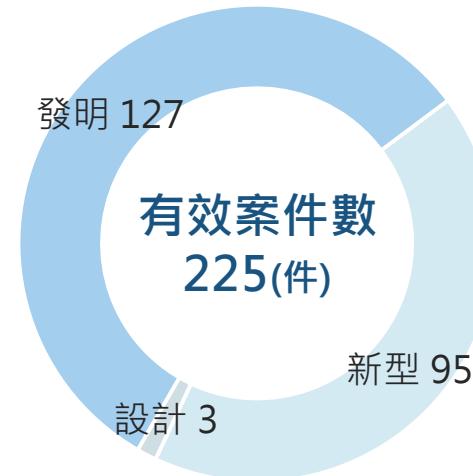
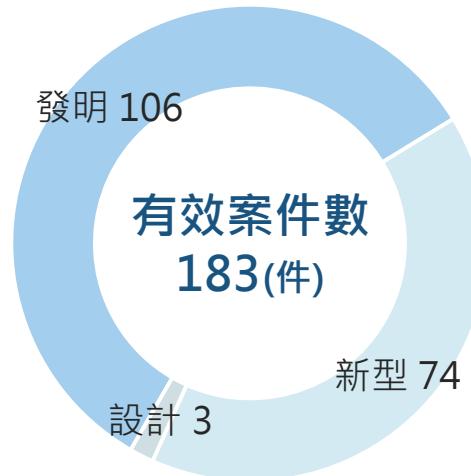
12U 15KW 浸沒式水冷槽
Fluid : Synthetic Oil (PAO Family)

產品優勢

- ◆ 唯一得到國際級客戶認證。

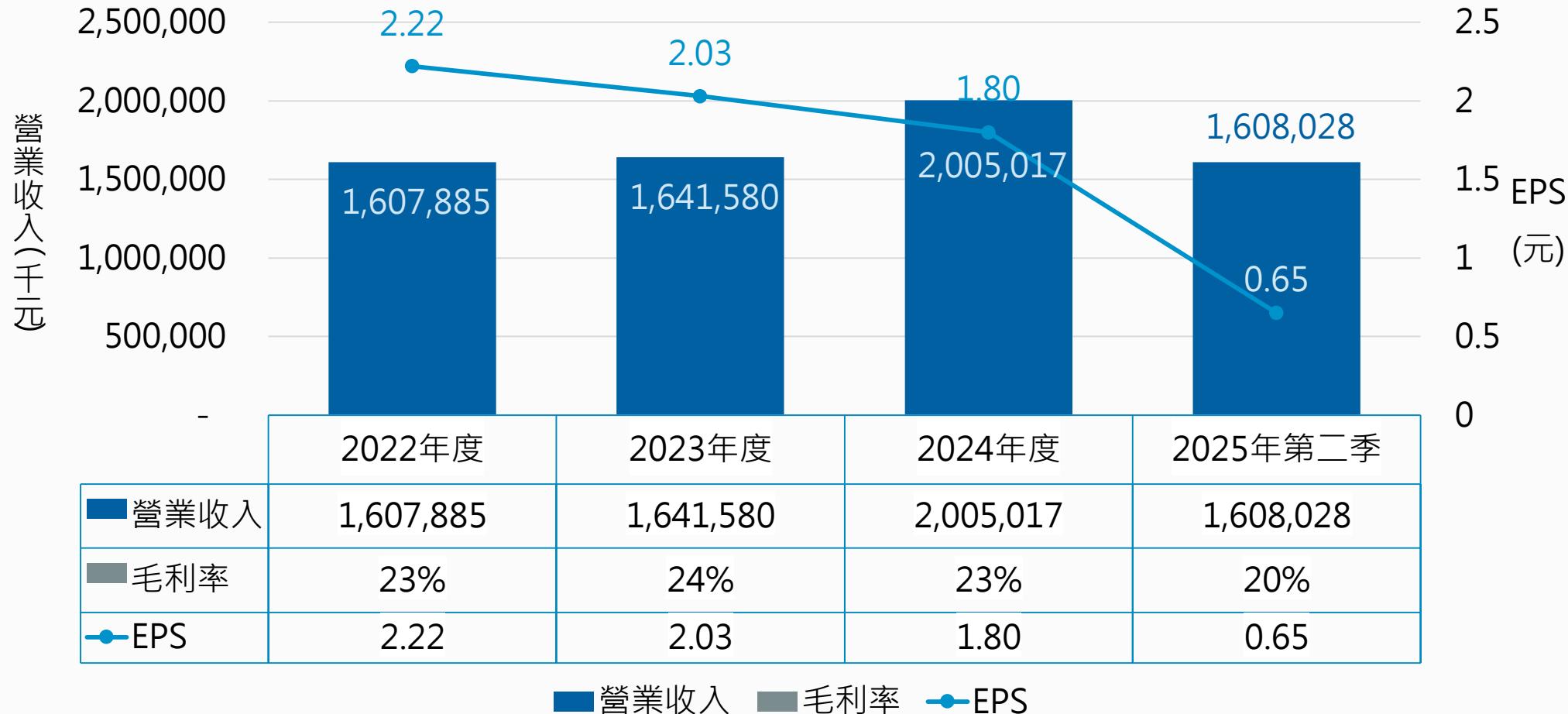
集團專利摘要(1/2)

專利有效案件統計



03 | 經營實績

財務資訊



04 | 永續發展

社會責任

公司治理

- ✓ 打造誠信為本的企業文化
- ✓ 建立完善暢通的檢舉管道

環境永續

- ✓ 韻應降低氣候負面影響
- ✓ 落實盤點公司溫室氣體

員工關懷

- ✓ 營造友善職場環境
- ✓ 保障性別工作平等

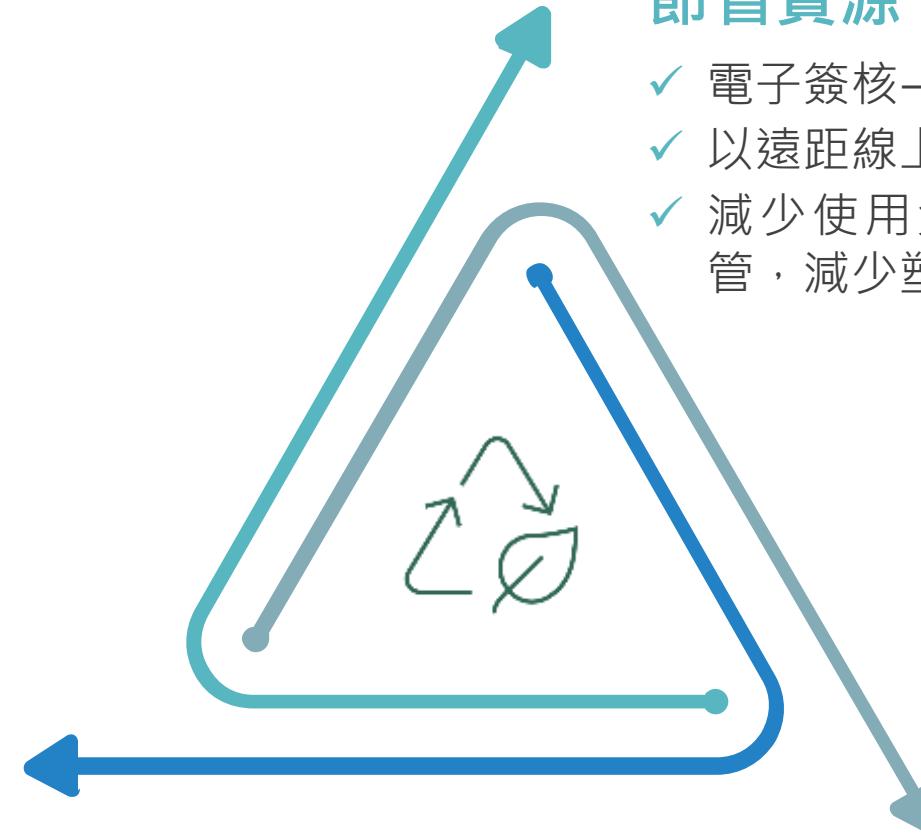
社會關懷

- ✓ 參與慈善活動
- ✓ 照顧弱勢組群

環境保護

節省能源

- ✓ 選用節能設備
- ✓ 增購儲能設備
- ✓ 空調溫度不低於26°C
- ✓ 午休時-電腦待機/關燈
- ✓ 下班後-電腦關機/關燈



節省資源

- ✓ 電子簽核→減少列印用紙
- ✓ 以遠距線上會議代替出差
- ✓ 減少使用免洗餐具/免洗吸管，減少塑膠垃圾

環境保護

- ✓ 垃圾分類，資源回收
- ✓ 搭乘大眾運輸交通工具

Thanks a lot!